

## 참가비

구분	1부스/7.5m <sup>2</sup> *소비세 별도
일반	375,000엔
회원기업*1	320,000엔

\*1 대상: WECC 회원

(CPCA, EIPC, ELCINA, HKPCA, IPC, IPCA, KPCA, TPCA)

※ 부스 한 칸의 면적이 기존의 9m에서 7.5m로 변경됩니다.

※ 부스의 설치 및 장식, 전기, 급배수, 전화요금, 부스 내부 청소비, 폐기물처리비 등의 공사비 및 사용료는 포함되어있지 않습니다.

## 신청방법

전시회 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하시기 바랍니다.

동봉한 출전신청서를 사용하실 경우에는 메일이나 팩스로 신청해 주십시오.

귀사에서 출전하실 제품이나 기술, 서비스에 적합한 전시 분야를 선택하시고, 반드시 출전신청서 뒷면의 '출전 계약'을 확인해 주십시오. 출전신청서가 수리되는 대로 청구서를 발행하오니, 명시된 기일까지 입금해주시기 바랍니다(사전입금원칙). 온라인으로 신청하신 경우에는 전시 홈페이지의 출전자 전용 페이지에서 청구서를 다운로드하실 수 있습니다.

## 신청 마감일

2020년 1월 31일 (금)

예정된 부스 수량이 모두 소진되면 접수를 마감하오니 양해해주시기 바랍니다.

## 취소 수수료

출전 신청자의 사정으로 전시회 출전을 취소하는 경우(전부 또는 일부)에는 아래와 같이 취소 수수료를 받습니다.

서면으로 취소 통지를 수리한 날	취소 수수료
2020년 2월 1일 (토) 까지	부스 요금의 50%
2020년 2월 2일 (일) 이후	부스 요금의 100%

## 개최까지의 일정 (예정)

2020년 1월	2월	3월	4월	5월
▲ 1/31 (금) 최종신청마감	▲ 2/18 (화) 참가자설명회 (도쿄) 2/20 (목) 참가자설명회 (오사카)		4月上旬 초대장 배부 (예정)  4月下旬 참관객 사전등록 시작 각종 제출서류 마감	5/25 (월) ~ 5/26 (화) 반입기간  5/27 (수) ~ 5/29 (금) 전시회 개최 ※최종일 당일 철거

## 【올해 개최장소는 아오미 전시장입니다.】

2020 도쿄올림픽 패럴림픽 경기대회 개최로 인해, 회장 이용이 제한됩니다. 2020년도 전시면적이 작년의 80% 수준으로 축소됩니다. 보다 많은 기업의 참가를 위해, 과거 이용하셨던 부스의 최대 개수보다 많은 수의 부스 이용은 자제해주시기 바랍니다. 또한 복수 신청의 경우, 출전기업 한 곳당 부스의 개수를 제한하는 경우가 있사오니, 이 점 양해해주시기 바랍니다.

- 한 부스 당 면적** : 부스 한 칸의 면적이 기존의 9m에서 7.5m로 변경됩니다.
- 플로어 레이아웃** : 플로어 레이아웃에 대해서는 정해지는 대로 전시회 홈페이지를 통해 안내해 드리겠습니다.
- 부스 위치 결정** : 부스의 수, 과거 출전 이력, 회원가입 여부에 따라 주최자가 결정하여, 참가자 설명회에서 발표합니다.
- 부스 제작에 대해** : 효율적인 설치 및 철거를 위해, 패키지 부스 이용에 협조해주시기 바랍니다.  
자세한 내용은 별도로 안내해드립니다.

## 부스 형태



## 출전자 서포트 프로그램

유료

바코드리더 서비스, 각종 광고 플랜 등, 출전의 효과를 높이기 위한 프로그램이 준비됩니다.

## 패키지 부스

가격: 73,000엔 (소비세 별도(예정))

소재: 시스템패널

※사양, 가격은 변동될 수 있습니다.



본부사무국

일반사단법인 일본전자회로공업회

Secretariat Office

JTB Communication Design, Inc.

Celestine Shiba Mitsui Building, 3-23-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-8335  
TEL: +81-3-5657-0767 FAX: +81-3-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp



JPCA Show

제50회 국제전자회로산업전

JIEP Microelectronics Show

제34회 최첨단 실장기술, 패키징 전시회

JISSO PROTEC

제22회 실장 프로세스 테크놀로지 전시회



유기 디바이스 종합전

IoT 대응 반도체 및 회로 기판전



WIRE Japan Show

전기 및 광전송 기술전

Smart Sensing

스마트 센싱

JEP/TEP Show

전국전자부품유통연합회  
도쿄도 전기도매상업협동조합

E-Textile

전자섬유 전



のせる つなぐ つくる そして ひろげる

5.27 ▶ 5.29 전시회 참가안내

도쿄 빅사이트 아오미 전시장 모든 홀+TFT홀  
전자기기 2020  
토탈 솔루션전시회

www.jpccashow.com

주 최 : 일반사단법인 일본전자회로공업회, 일반사단법인 일렉트로닉스 실장학회,  
일반사단법인 일본로봇공업회  
공동주최 : 전자 디바이스산업신문 ((주) 산업타임즈사), 전선신문 ((주) 공업통신)  
JTB Communication Design, Inc.  
전국전자부품유통연합회 / 도쿄도 전기도매상업협동조합  
후쿠이현전자섬유(E-textile)제품개발연구회  
후 원 : 경제산업성

해외 협력 : 세 계전자회로업계 단체협의회 (WECC) 가맹 단체  
CPCA(중국 PCB 협회), EIPC(유럽 PCB 협회), ELCINA(인도 전자 공업회),  
HKPCA(홍콩 PCB 협회), IPC(미국 PCB 협회), IPCA(인도 PCB 협회),  
KPCA(한국전자회로산업협회), TPCA(대만 PCB 협회)

# 5G, 자동차, IoT, 로봇, 웨어러블 등을 구현하는 기술종합전시회



전자기기 2020  
 토탈 솔루션전시회  
 www.jpccashow.com

일렉트로닉스 전시회 중에서도 전문성과 주목도가 높으며, 널리 국내외에서 오신 수많은 참관객을 맞이하여 활발한 비즈니스의 장으로써 활용하실 수 있습니다.

## 아오미 전시장/TFT홀 오시는 길



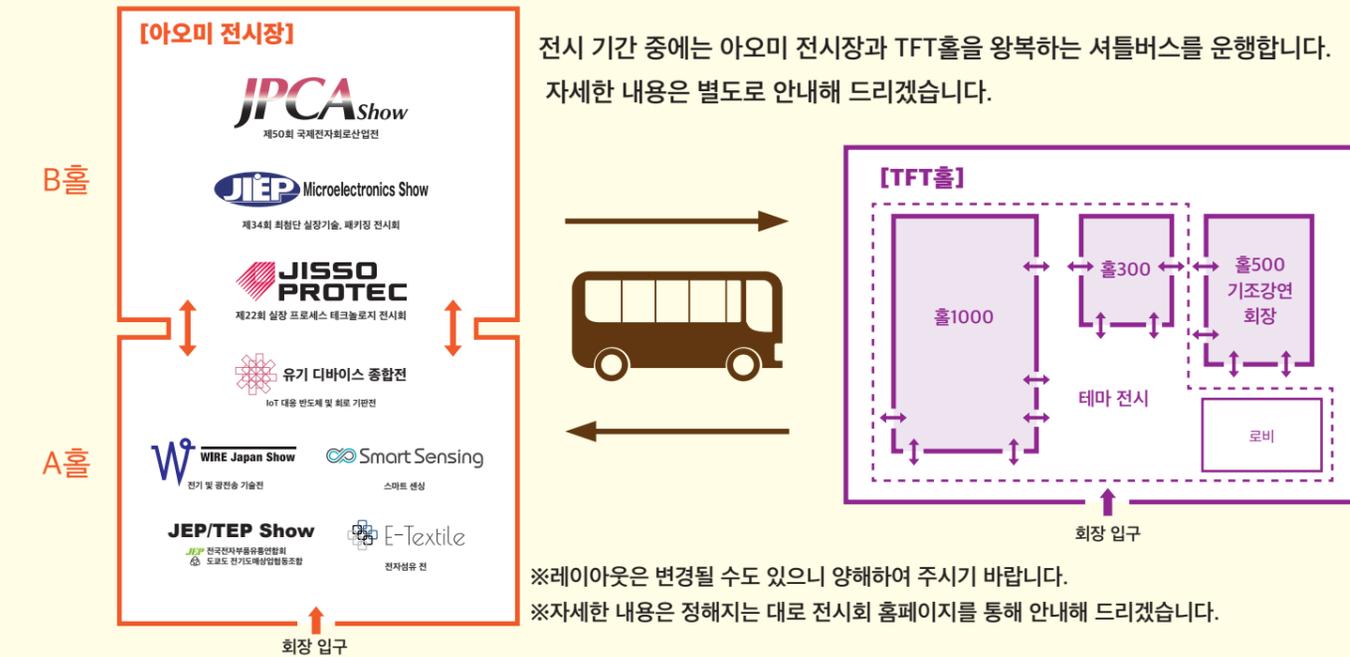
### 아오미 전시장과 가장 가까운 역

- ◎유리카모메 아오미 역에서 도보 약 4분
- ◎린카이선 도쿄텔레포트 역에서 도보 약 2분

### TFT홀과 가장 가까운 역

- ◎유리카모메 도쿄빅사이트 역에서 도보 약 1분
- ◎린카이선 국제전시장 역에서 도보 약 5분

## 전시회 레이아웃 안



## 2019년도 실적

- 회장** 도쿄 빅사이트 서1~4홀+회의동
- 참가 규모** 507개사 / 1,372 부스
- 방문객 수** 44,110명
- 세미나 청강자 수** 11,421명

## 무료 참가자 프레젠테이션

전시회 참가의 효과를 높이기 위해 이용하시기 바랍니다.  
 패널이나 포스터 만으로는 부족한 정보 전달 및 홍보를 위해!!

- 세미나 회장 (30분 강연)
- 발표용 기기 완비

※강연일시는 신청하실 때 선착순으로 선택하실 수 있습니다.

## 주요 방문 기업

- 자 동 차 관 련 아이신 세이키, 아사히 덴소, 이치코 공업, 칼소닉칸세이, 게이힌, KOA, 고이토 제작소, 스탠리 전기, 스미토모 덴소, 다이하쓰 공업, 덴소, 도카이리카, 도요 덴소, 도요타 자동차, 닛산 자동차, 브리지스톤, 니혼하쓰조, 파이오니아, 히타치 오토모티브시스템즈, 히노 자동차, SUBARU, 혼다기연공업, 마쓰다, 미쓰비시 자동차공업, 야자키 부품
- O A 및 로 보 틱 스 오므론, 키엔스, 캐논, 코니카미놀타, 사이버다인, 산요 전기, JUKI, 세이코 엡슨, 파나소닉, 파나소닉 스마트 팩토리 솔루션즈, 화낙, FUJI, 후지 제록스, 미쓰비시 전기, 야스카와 전기, 야마하 발동기, 리코 인더스트리, 리코 재팬
- 정 보 · 통 신 관 련 애플, 이토추 테크놀로지, 인텔, NHK 미디어 테크놀로지, NTT, NTT 도코모, 오키 전기공업, 한국방송공사(KBS), 교세라, KDDI, 소프트뱅크, 도쿄 방송 홀딩스(TBS), 도시바 정보시스템, 일본 IBM, 일본 삼성, 일본 전기, 일본 마이크로소프트, 일본 유니시스, 파나소닉, PFI, 히타치 제작소, Huawei, 후지쿠라, 후지쓰, 무라타 제작소
- A V · 가 전 관 련 아이리스 오야마, LG전자, 카시오 계산기, 캐논, Samsung Electronics, 샤프, 소니, 소니 글로벌메뉴팩처링&오퍼레이션즈, 소니 세미컨덕터솔루션즈, 다이킨 공업, TOTO, 니콘, 파이오니아, 파나소닉, 후지쓰 제너럴, 야마하, 플랜드
- 의 료 기 기 관 련 아사히카세이, 예자이, 올림푸스, Siemens, 시마즈 제작소, 시라카와 올림푸스, 데루모, Canon 메디컬 시스템즈, 히타치 하이테크놀로지, 히타치 헬스케어메뉴팩처링, 후지필름, 마크 전자, 모리타도쿄제작소
- 반 도 체 디 바 이 스 관 련 인텔, ST마이크로일렉트로닉스, 캐논, 삼성전자, SCREEN 홀딩스, 소니, TDK, 도쿄 일렉트론, 도시바 메모리, 니콘, 히타치 하이테크놀로지즈, 후지쓰 세미컨덕터, 마이크로 재팬, 르네사스 일렉트로닉스, 로움
- 항 공 · 우 주 관 련 IHI, NEC 스페이스 테크놀로지, JAXA(우주항공연구개발기구), 신포니아 테크놀로지, 나브테스코, 나리타 에어포트, 미즈호 은행, 일본 아비오니크스, 일본 전기, 미쓰비시 중공업, 미쓰비시 전기
- 기 타 해상 자위대, 간사이전력, 육상 자위대, 도쿄가스, 도쿄전력홀딩스, 도카이여객철도, 서일본여객철도, 동일본여객철도, 미즈호 은행
- 전 자 회 로 기 관 어드반테스트, 이스턴, 이비덴, 에루나, 교에이 산업, 교샤, 교세라, 교덴, 시라이 전자공업, 신코 제작소, 신코 전기공업, 스미토모 덴코 프린트 서킷, 다이쇼 전자, 닛토 덴코, 일본 CMK, 일본 맥트론, 파나소닉, 히타치카세이, 후지쿠라, 후지쓰 인터커넥트 테크놀로지즈, 호리바 제작소, 메이코, 야마시타 머티리얼, 리소 공업

## 전시회 구성, 참가 대상

전자회로기술	고밀도 실장기술	전자부품 실장기술	신규 회로 형성 기술	전기 및 광전송 기술	센서 기술	반도체 전자부품	고기능 텍스타일
<p>제50회 국제전자회로산업전</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●프린트 배선판 기술전 제품 (전자회로기판 등의 전자기기), 설계기술, 신뢰성/검사기술, 주재료/절연재료, 2차원 재료/프로세스재료/기판재, 제조설치/설비, 환경시스템, 물류시스템</li> <li>●반도체 패키징 부품 내장기술전 모듈 기판 / 모듈 기판 실장 / 부품내장에 관한 기술 전반 ( 제품 / 관련 제품 / 설계 / 신뢰성 검사 / 재료 및 기능재료 / 관련 장치 / 관련 시스템 )</li> <li>●플렉시블 프린트 배선판 제품 출현 구역 플렉시블 프린트 배선판에 관한 기술 전반 ( 제조 )</li> <li>●기기 반도체 수탁생산 시스템전 EMS 등 전기전자기기 및 반도체에 관한 수탁서비스 전반</li> </ul> <p>【주최 : 일반사단법인 일본전자회로공업회】</p>	<p>제34회 최첨단 실장기술, 패키징 전시회</p> <p>실장 및 전자기술에 관한 기술 전반 ( 재료 / 회로 및 실장설계 / 고속고주파 / 전자특성 / 전자부품 및 실장 / 광회로 실장 / 환경조화형 실장 / 반도체 패키징 / 마이크로 메카트로닉스 실장 기술 / 각종 관련 제조장치 )</p> <p>【주최 : 일반사단법인 일렉트로닉스 실장학회】</p>	<p>제22회 실장 프로세스 테크놀로지 전시회</p> <p>전자부품 실장에 관한 기술 전반 ( 전자부품 실장기 및 시스템 / 반도체 실장기·시스템 / 검사기술 및 시스템 / 실장설계시스템 / 각종 로봇 )</p> <p>【주최 : 일반사단법인 일본로봇공업회】</p>	<p>IoT 대응 반도체 및 회로 기판전</p> <p>유기 디바이스에 관한 기술 전반 ( 프린트드 일렉트로닉스 제품 및 부품 / MEMS (초소형 정밀기계 기술) / 센서 LED / OLED / 유기반도체 관련 응용제품 )</p> <p>【공동주최 : 일반사단법인 일본전자회로공업회·전자 디바이스산업신문 ((주) 산업타임즈사)】</p>	<p>전기 및 광전송 기술전</p> <p>와이어, 케이블 등을 이용한 전송기술 전반 ( 산업용 기기 / 전선, 케이블 및 커넥터 / 전선 가공기 / 배선용 부재 / 와이어하네스 / 전선, 케이블용 계측기 / 각종 장치 / 검사기술 / 장치간(M2M) 전송 / 광전송 )</p> <p>【공동주최 : 일반사단법인 일본전자회로공업회·전선신문 ((주) 공업통신)】</p>	<p>스마트 센싱</p> <p>센서 및 센싱 시스템에 관한 기술 전반 ( 센서/센서노드 관련, 반도체/부품 디바이스, 전자기기, 통신 디바이스/네트워크 시스템, 소프트웨어 관련, 데이터 플랫폼, 전원, 기타 주변기기/기술/서비스 )</p> <p>【공동주최 : 일반사단법인 일본전자회로공업회·JTB Communication Design, Inc.】</p>	<p>전국전자부품유통연합회 도쿄도 전기도매상업협동조합</p> <p>반도체 전자부품 등을 이용한 솔루션 기술 전반 ( 반도체 / 전자 디바이스 / 센서 / 기구 부품 / FA제어기기 / 계측기 / 전원 / IoT/M2M솔루션 제안 / 제작 솔루션 시스템 )</p> <p>【공동주최 : 일반사단법인 일본전자회로공업회·전국전자부품유통연합회/도쿄도 전기도매상업협동조합】</p>	<p>전자섬유 전</p> <p>전자기술과 섬유, 의복재료가 융합한 전자섬유 (스마트 텍스타일/스트레처블 기술/웨어러블 기술)에 관한 기술 전반 ( 섬유 소재 및 재료 / 도전성 소재 및 재료 / 방직기술 / 프린트 마킹 기술 / 필름 )</p> <p>【공동주최 : 일반사단법인 일본전자회로공업회·후쿠이현전자섬유 (E-textile)제품개발연구회】</p>